

製品概要

太陽誘電社製BLE(Bluetooth Low Energy)モジュールを、取り扱いが容易なDIP16形状にしました。端面スルーホール加工により、薄型化(厚さ約2.5mm)・小型化(23.5×8.3mm)を実現しました。ユニバーサル基板等へ直接はんだ付けすることができ、セットの薄型(厚さ約2.5mm)・小型化が可能です。ピンの列間隔が300mil(7.62mm)より広く(8.0mm)なっておりますので、ブレッドボードなどお使いの場合は、通販番号P-03635 型番 2227MC-16-03-150-F6の連結ソケット16Pのご使用をおすすめします。BLEモジュールの仕様につきましては、詳細資料がダウンロードできますので、そちらをご参照ください(要ユーザ登録…詳細はカード内側をご覧ください)。



←端面スルーホール

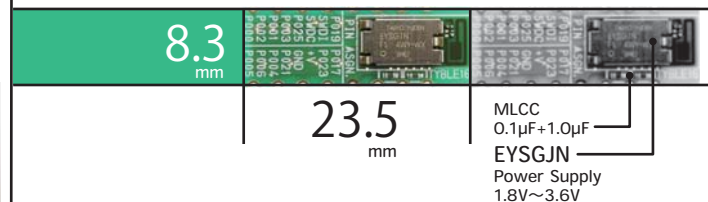
ブレッドボードと連結ソケット16Pとの組み合わせ例→



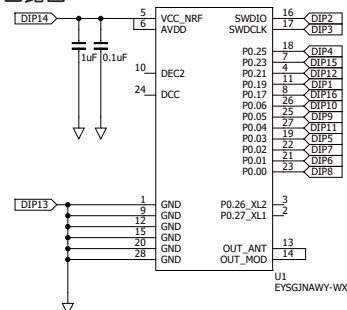
ブレッドボード、連結ソケットは別売です。

AE-TYBLE16

TAIYO YUDEN EYSGJN Bluetooth Ver 4.2 Low Energy Module

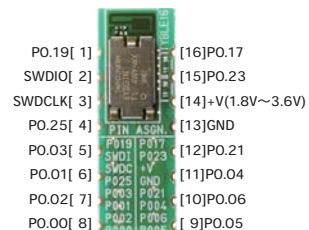


回路図



DIPで始まる表記は、モジュールのピン番号に対応します。(例) DIP1 → モジュールの1番ピン
本モジュールは、V1.3の資料に基づき部品定数を決定しております。最新版の資料とは、値が異なる場合がございます。

ピン配置



EYSGxNAWY-WX Data Report (full version)

詳細仕様書の入手方法

http://www.yuden.co.jp/wireless_module/Module/ にアクセスし、必要事項を入力、ユーザ登録を完了すると、詳細資料をダウンロードすることができます。登録の際には、下記コードが必要となりますので無くさないようご注意ください。

Product Passcode

<商品添付のカードに印字>



ダウンロード手順につきましては、下記URLの手順書をご参照ください。
akizukidenshi.com/download/ds/akizuki/yuden-spec-pdf-dl-howto.pdf

詳細仕様書は、製品を購入したお客様向けの機密情報です。
第三者への情報提供、開示、配布、共有、公開はしないで下さい。